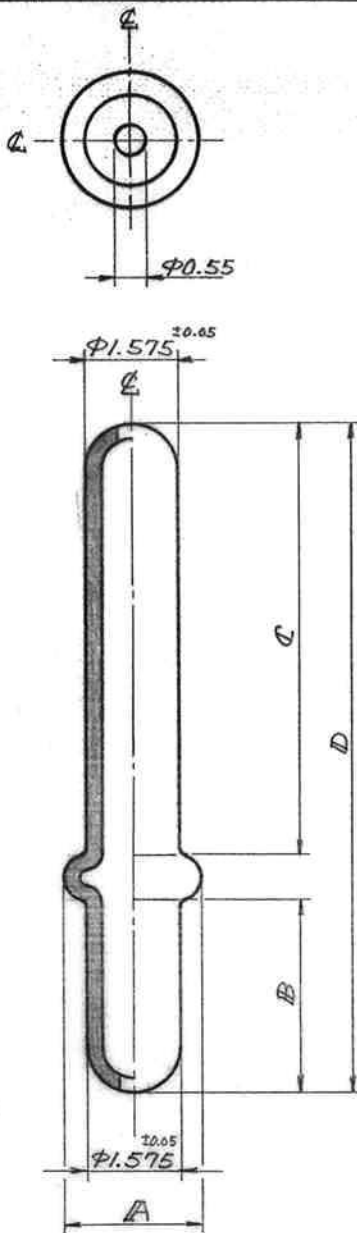


ENG. NO. SD-R62-\*

EDP NO. 16-06-00\*\*



注記

1. 推奨プリント基板穴径:  $\phi 1.65$  <sup>±0.05</sup>

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

角度 ANGLE	± 3°	16-06-0010	R62-5	φ2.55	3.68	7.1	11.55	錫メッキ(3μmin.)
30 以上 OVER	±0.3	↓	↓					
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25	↓	↓	φ2.28	3.18	10.15	14.1	錫メッキ(3μmin.)
10 未満 UNDER	±0.2	16-06-0004	R62-3	φ2.29	3.18	7.11	11.05	錫メッキ(3μmin.)
一般公差 GENERAL TOLERANCES		EDP NO.	ENG. NO.	A	B	C	D	メッキ仕様 備考

材料 MATERIAL		貴銅		MOLEX MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上 FINISH		長参照		EDP NO. 16-06-00**	
適用電線範囲 WIRE RANGE				ENG. NO. SD-R62-*	
被覆外径 INS. RANGE				REV D	
D REVISED ECN No. 2395 MS 4/1/82	DRAWN BY		CHK'D BY		TITLE 名称: BEAD PIN
C REDRAWN ECN No. 789 4/25/78	APP'D BY		尺 度 SCALE 8-1		
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE		